



## 标题：供应商材料限用物质管理办法

1. 目的：阐明深圳华映显示科技有限公司（以下简称 SDT）在产品上为符合欧盟 RoHS 指令及客户之要求，特订定本办法以管制 SDT 产品及其它零(附)组件之限用物质含量。
2. 范围：凡构成 SDT 产品的部件（part）、元件（component）、包装（package）等材料及制造过程中所使用之化学物质（chemical）。经制程限用物质鉴别作业，判定为二级(于过程中，与产品直接接触，但不会沾附与残留于产品上)，或判定为三级(于过程中，不会与产品直接接触，不会有污染之疑虑)，此范围不适用。
3. 定义：
  - 3.1ppm：百万分之一（parts per million）。
  - 3.2N.D.：不得检出（Non Detected）。
  - 3.3 均质材料：指不能通过机械手段进一步拆分为不同材料的材料，均质材料各部分的组成均相同，例如各种陶瓷、玻璃、金属、合金、纸、木板、树脂、塑料以及涂料等。
  - 3.4 机械拆分：运用机械手段进行有效的划分和获取检测单元的过程，包括旋开、切割、刮削、挤压和研磨等。
  - 3.5MSDS：Material Safety Data Sheet 物质安全资料表。
4. 权责：
  - 4.1采购：向上游供应商采购各零(附)组件、原物料时要求供应商提供环保保证书、检测报告、MSDS等材料。
  - 4.2品保：供应商提供限用物质相关数据汇总并审核，以及提供培训。
  - 4.3行销业务/CS：负责及时传达客户要求之产品环保材料条件，避免影响公司产品销售与营运。
  - 4.4生产：确保量产后之产品不受污染、混料，如需变更制程，须知会QS与制程相关单位，以确保信息传承与有害物质材料不被误用。
  - 4.5物流企划：确保现场使用之材料与客户需求之产品不被误用、误领，避免造成SDT与其客户之损失。
5. 作业流程：无。
6. 内容：
  - 6.1 限用物质之管制：
    - 6.1.1 限用物质标准：如《限用物质成分一览表 T-SP-042-A》所列之管制物质与含量标准。
    - 6.1.2 允许排除条款：此物质原本就为了某些用途使用，在技术上或科学上替代是不实际的，无法以其他物质予以取代，或取代后形成环境/安全卫生之负面影响加重，因而被允许使用，依据“限用物质成分排除条款”实施。
    - 6.1.3 检测准则：《限用物质成分一览表 T-SP-042-A》中“检测分析报告”栏为“Y”者，表示供应商必须实施之检测项目；其余项目则由供应商自行挑选，针对产品中有疑虑之部分实施检测，以确认提供产品保证无误，但若 SDT 之客户坚持要求检测分析，则必须提供；制造过程中若有使用的限用物质也必须提供检测报告。
    - 6.1.4 材料宣告：签署《SDT 供应商材料使用物质证明宣告书 T-SP-042-E》。宣告产品、零件、材料及制造过程中，不得使用之限用物质。不符合则必须提出改善计划。
    - 6.1.5 所有供应商需关注冲突金属的来源，包含钽（Ta）、锡（Sn）、钨（W），金（Au），钴（Co）和钯（Pd）等金属。
      - (1) 冲突金属是指，钽（Ta），锡（Sn），钨（W），金（Au），钴（Co）和钯（Pd）等金属，来自于刚果民主共和国非政府军事团体或非法军事派别所控制冲突地区的矿区。当地军事团体取得的非法采矿利润是从公民中盗窃得来的，而且在刚果民主共和国东部造成侵犯人权，环境恶化。



## 标题：供应商材料限用物质管理办法

(2) 深圳华映显示科技有限公司 (SDT) 期望，我们的供应商遵守电子产业行为准则，只从对环境和社会负责的供应商采购材料。中华映管已采取行动，以确保我们的供应商符合这些期望。然而，由于复杂的金属供应链，我们目前无法核实使用在我们的产品中所有金属的原产地。

(3) 为了支持以上这一点，深圳华映显示科技有限公司 (SDT) 要求供应商：如果有冲突金属用于提供给深圳华映显示科技有限公司 (SDT) 的物品时，请立即告知深圳华映显示科技有限公司 (SDT)；要求供应商与他们的供应链进行商业上合理的尽责调查，以保证提供给深圳华映显示科技有限公司 (SDT) 的物品中使用的金属并没有来自冲突地区。

### 6.2 注意事项：

6.2.1 制程中除允许排除条款所列之使用外，不得使用或特意添加《限用物质成分一览表 T-SP-042-A》所列之限用物质，若为纯物质中不可除去之杂质含量，不得超过限用物质含量标准。

6.2.2 提供 SDT 产品部件、元件、包装材料之供应商，必须于量产之材料导入阶段提出限用物质检测报告、物质安全资料表 (MSDS)、供应商材料使用物质证明宣告书等资料。

6.2.3 检测项目如《限用物质成分一览表 T-SP-042-A》，检测之材料除了有特别定义外，必须以均质 (homogeneous) 材料进行检测。

6.2.4 CPT 认可的检测机构，目前包括 (包含其各地分属机构)：

- (1) SGS——瑞士通用公证行。
- (2) Intertek——天祥集团 ITS 公证行。
- (3) BV——法国国际检验集团 (法国船级社)。
- (4) TÜV——德国莱茵 TÜV 集团。
- (5) ITRI——财团法人工业技术研究院。
- (6) IST——宜特科技股份有限公司。
- (7) ETC——财团法人台湾电子检验中心。
- (8) CTI——华测检测机构。

6.2.5 若供应商无法经由上述检测机构实施检测分析时，请于检测前向 SDT 提出说明。实验室需通过 ISO17025 认证并取得认可证书，证书上之测试领域须包含 CPT 要求提供检测报告之检测项目，且核发证书的认证机构必须为 ILCA MRA (国际实验室认证联盟相互承认办法) 签署会员国的实验室认证机构。

6.2.6 供应商之事项配合与资料齐全，将列入 SDT 采购考量因素之一。SDT 将组成稽核团队针对各供应商实施稽核业务，届时请提出限用物质管理程序与记录。

6.2.7 若开发导入中产品检测超出限用物质标准，SDT 将要求供应商提出改善计划，并列为采购考量因素，至改善完成后始能接受供应商之产品；若量产后检测超出限用物质标准，须停止供货进行调查，后续依 SDT 相关采购、品质合约规范办理。

6.2.8 本办法为 SDT 因应各客户要求所订定之标准，若有变更，SDT 将同步修改标准并通知各供应商协同改善。本办法修订实施后，供应商须于收到通知日起，针对 SDT 开发之新产品，供应符合新版限用物质标准的产品材料。

6.2.9 第三方检测报告的有效期为一年。

6.2.10 供应商必须配合改善产品的环境品质、确保供应之产品被允许进入各国市场，有助于 SDT 与供应商达到互利共生、永续发展的目标。SDT 需对供应商进行培训，以召开供应商大会或专案培训形式，向供应商宣导我司环境管理方案及欧盟最新动态，频率最少一年一次。

6.2.11 本办法若有未尽之处，应适用 SDT 其他规范。

6.2.12 SDT 以 GPM 系统作为各产品部件、元件、包装等材料供应商上传检测报告的 platform，厂商有接受上课受训的义务并且需要定期维护及按时更新资料。GPM 系统网址：<http://plmreport.cptt.com.tw/bindex.htm>



## 标题：供应商材料限用物质管理办法

### 6.2.13 检测分析报告的合格条件：

- (1)SDT 认可的检测机构（见 5.4）。
- (2)原检测机构电子档分析报告，必须为电子档原稿，不接受影印、删修、涂改后的报告。
- (3)一年之内的分析报告。
- (4)检测分析报告须为中、英文版本。

### 6.2.14 完整的检测分析报告内容要包含有：

- (1)报告编号。
- (2)产出报告时间。
- (3)页码。
- (4)送测厂商名称及地址。
- (5)样品描述。
- (6)测试时间。
- (7)测试机构 logo。
- (8)测试机构负责人签字。
- (9)测试机构联系方式。
- (10)分析方法。
- (11)分析物的照片。
- (12)测试流程图。
- (13)测试结果和 MDL（方法检测下限）。

### 6.2.15 QS 发现不合格报告时，该份报告驳回，通知相关担当责令厂商提交合格报告，并记录存档。

### 6.2.16 QS 发现假报告时，该份报告驳回，并记录存档，QS 通知相关担当责令厂商重提报告。

- (1)对准备新导入的厂商，暂不导入，如果发现第二次，则不再导入该厂商。
- (2)对已有厂商，将与相关单位会议决定，视情节轻重，给予厂商一定处罚。

### 6.2.17MSDS 合格条件相关说明：

- (1)MSDS 格式包括：产品与厂商资料、成分辨识资料、危害辨识资料、急救措施、灭火措施、泄漏处理方法、安全处置与储存方法、暴露预防措施、物理及化学性质、安定性与反应性、毒性资料、生态资料、废弃处置方法、运送资料、法规资料、其他资料共 16 项。
- (2)MSDS 有效期为三年。

### 6.2.18 厂商所提交的限用物质检测报告和 MSDS 有效日期终止前一个月，QS 通知厂商准备新资料。厂商在检测报告到期时仍不能提交有效检测报告或 MSDS，报请管理者代表批示后继续动作。

### 6.2.19 厂商限用物质检测报告、MSDS 以及物质证明宣告书保存于 M 槽，由限用物质担当负责更新管理。限用物质检测资料及 MSDS 新旧版资料分开放置，旧版资料保存两年加一日历年。

- (1)对导入的新材料，限用物质相关资料从“材料导入系统”材料样式承认单附件中获取。
- (2)与 CPT 其他厂区公用的材料，定期更新的限用物质相关资料可从 GPM 系统下载。**

### 6.3 豁免条款：可属排除条款之应用项目是依据欧盟正式公告指令（如 2002/95/EC，2005/717/EC，2005/747/EC，2006/310/EC，2006/690/EC，2006/691/EC and 2006/692/EC）订定之。允许使用之排除条款如下：

#### 6.3.1 小型萤光灯的含汞量不超过每灯 3.0 mg(排外编号 Exemption No. 1)：Mercury in compact fluorescent lamps not exceeding 3.0 mg per lamp.

#### 6.3.2 一般用途直管萤光灯的含汞量每灯不超过(排外编号 Exemption No.2)：Mercury in straight fluorescent lamps for general purposes not exceeding: (per lamp) (预计到期日,Expected Expiry Date:2014.07.31)

##### 6.3.2.1 卤素磷酸盐 halophosphate: 10mg。



## 标题：供应商材料限用物质管理办法

- 6.3.2.2 正常寿命的三磷酸盐 triphosphate with normal lifetime: 5mg。
- 6.3.2.3 长效寿命的三磷酸盐 triphosphate with long lifetime: 8mg。
- 6.3.3 特殊用途直管荧光灯的含汞量(排外编号 Exemption No. 3)。Mercury in straight fluorescent lamps for special purposes. (预计到日期,Expected Expiry Date: It will be reviewed the applicability by 2012.12.31)。
- 6.3.4 不在此列管之含汞灯泡(排外编号 Exemption No. 4)Mercury in other lamps not specifically mentioned in this Annex. (预计到日期,Expected Expiry Date:2014.07.31)。
- 6.3.5 阴极射线管(CRT)、电子元件及荧光灯管使用的玻璃含铅量(排外编号 Exemption No. 5)。Lead in glass of cathode ray tubes, electronic components and fluorescent tubes (预计到日期,Expected Expiry Date:2014.06.30)。
- 6.3.6 使用于钢材中的含铅量最高为 0.35%(重量) (排外编号 Exemption No. 6a)、铝材中的含铅量最高为 0.4%(重量) (排外编号 Exemption No. 6b)、铜材中的含铅量最高为 4%(重量) (排外编号 Exemption No. 6c)。Lead as an alloying element in steel containing up to 0.35% lead by weight, aluminum containing up to 0.4% lead by weight and as a copper alloy containing up to 4% lead by weight. (预计到日期,Expected Expiry Date:2013.12.31)。
- 6.3.7 用于高熔点焊锡中的铅(如锡-铅焊料合金含铅量 85%以上) (排外编号 Exemption No. 7a)。Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead)。 (预计到日期,Expected Expiry Date:2013.06.30)
- 6.3.8 含铅之焊锡使用于伺服器、储存槽与储存阵列系统中、网路配备如开关、信号、传输、电信网路管理等(排外编号 Exemption No. 7b)。Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signaling, transmission as well as network management for telecommunications. (预计到日期,Expected Expiry Date: 2014.07.31)。
- 6.3.9 电子陶瓷元件(如压电装置)的含铅量(排外编号 Exemption No. 7c)。Lead in electronic ceramic parts (e.g. piezoelectronic devices)。 (预计到日期,Expected Expiry Date:2014.07.31)。
- 6.3.10 含有镉及其化合物的电力接点与电镀镉的使用，不包含 91/338/EEC 与 76/769/EEC 指令之禁制规范 Cadmium and its compounds in electrical contacts and cadmium plating except for applications banned under Directive 91/338/EEC (OJ L 186, 12.7.1991, p.59.) amending Directive 76/769/EEC (OJ L 262, 27.9.1976, p. 201.) relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations.
- (1)Cadmium and its compounds in one shot pellet type thermal cut-offs. (排外编号 Exemption No. 8a) (预计到日期,Expected Expiry Date:2011.12.31) (客户额外要求 Customers' additional requests:2010.12.31)。
- (2)Cadmium and its compounds in electrical contacts. (排外编号 Exemption No. 8b) (预计到日期,Expected Expiry Date:2014.07.31)。
- 6.3.11 吸收式冷藏柜冷却系统使用六价铬防腐剂(排外编号 Exemption No. 9) Hexavalent chromium as an anti-corrosion of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators. (预计到日期,Expected Expiry Date:2013.12.31)。
- 6.3.12 铅使用于铅铜轴承壳(bearing-shell)及轴衬(bush)中(排外编号 Exemption No. 9b)Lead in lead-bronze bearing shells and bushes. (预计到日期,Expected Expiry Date:2014.06.30)。
- 6.3.13 根据在 2002/95/EC 第 7(2)条中提及的程序，欧盟委员会应评估以下方面的应用：Within the procedure referred to in Article 7(2), the Commission shall evaluate the applications for:
- (1)特殊用途的直管日光灯中的汞 mercury in straight fluorescent lamps for special purpose。
- (2)以下用途中所使用的焊料中的铅：伺服器、存储器、用于交换和传输的网路基础设施、电信网路管理设备（旨在设定本指令豁免部分的特定截止时间）lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signaler, transmission as well as network management for telecommunications (with a vi



## 标题：供应商材料限用物质管理办法

ew to setting a specific time limit for this exemption)。

(3)灯泡 light bulbs。

- 6.3.14 光学玻璃及滤光玻璃中所用的铅及镉(排外编号 Exemption No. 13)Lead and cadmium in optical and filter glass. (预计到期日,Expected Expiry Date:2014.07.31)。
- 6.3.15 铅使用于积体电路覆晶封装内部的焊锡；介于半导体晶片和载体间，来完成电力连结(排外编号 Exemption No.15)Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit Flip Chip packages. (预计到期日,Expected Expiry Date:2014.07.31)
- 6.3.16 管状白炽灯硅酸盐涂层灯管中的铅(排外编号 Exemption No.16)Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes.
- 6.3.17 专业复印设备用的高强度放电灯中作为发光剂的卤化铅(排外编号 Exemption No. 17) Lead halide as radiant agent in High Intensity Discharge (HID) lamps used for professional reprography applications. (预计到期日,Expected Expiry Date:2014.07.31)
- 6.3.18 当放电灯被用作含磷仿日晒灯(如 BSP)、或二氮化合物列印、平版印刷、捕虫器，以及含磷化学和含磷食物加工过程的专业灯时(如 SMS)，放电灯中的荧光粉触媒剂的铅(铅含量1%以下) (排外编号 Exemption No. 18)Lead as activator in the fluorescent powder (1% lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi2O5:Pb) as well as when used as speciality lamps for diazo--printing reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).
- 6.3.19 紧缩节能灯中作为汞的特定成分中 PbBiSn-H 及 PbInSn-Hg 中的铅以及作为辅助汞合金中 PbSn-Hg 中的铅(排外编号 Exemption No. 19)Lead with PbBiSn-Hg and PbInSn-Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as auxiliary amalgam in very compact Energy Saving Lamps (ESL).
- 6.3.20 用于硼硅玻璃瓷漆的印刷油墨所含的铅及镉(排外编号 Exemption No. 21)Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on borosilicate glass. (预计到期日,Expected Expiry Date:2014.07.31)
- 6.3.21 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅(排外编号 Exemption No. 24)Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors. (预计到期日,Expected Expiry Date:2014.07.31)
- 6.3.22 等离子显示屏(PDP)及表面传导式电子发射显示器 (SED)的构件所用的氧化铅(排外编号 Exemption No. 25)Lead oxide in plasma display panels (PDP) and surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural elements; notably in the front and rear glass dielectric layer, the bus electrode, the black stripe, the address electrode, the barrier ribs, the seal frit and frit ring as well as in print pastes. (预计到期日,Expected Expiry Date:2014.07.31)
- 6.3.23 蓝黑灯管 (BLB)玻璃外罩所含的氧化铅(排外编号 Exemption No. 26)Lead oxide in the glass envelope of Black Light Blue (BLB) lamps.
- 6.3.24 在大功率扬声器中作为转换器焊料的铅合金(排外编号 Exemption No. 27)Lead alloys as solder for transducers used in high-powered (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) loudspeakers.
- 6.3.25 在欧盟第 69/493/EEC 号指令附件一第 1、2、3 及 4 分类定义下之水晶玻璃铅(排外编号 Exemption No. 29)Lead bound in crystal glass as defined in Annex I (Categories 1, 2, 3 and 4) of Council Directive 69/493/EEC (\*).(预计到期日,Expected Expiry Date:2014.07.31)
- 6.3.26 使用于声压大于或等于 100 分贝的高功率音箱中的音圈转换器上的电导体的电子或机械焊点中的镉合金(排外编号 Exemption No. 32) Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located directly on the voice coil in transducers used in



---

**标题：供应商材料限用物质管理办法**

---

high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A) and more.

6.3.27 于无汞平面荧光灯(使用于液晶显示器、设计或工业照明设备)中焊锡内含的铅(排外编号 Exemption No. 30) 于Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps(which e.g. are used for liquid crystal displays, design or industrial lighting).

6.3.28 封装氩和氦雷射管的氧化铅(排外编号 Exemption No. 31)。

7. 参考文件：

7.1 限用物质管制程序 SP-042。

8. 使用表单：

8.1 限用物质成分一览表 T-SP-042-A。

8.2SDT 供应商材料使用物质证明宣告书 T-SP-042-E。

9. 记录：

9.1 《限用物质成分一览表 T-SP-042-A》为电子档，于“ISO 文件管理系统”中永久保存。

9.2 《SDT 供应商材料使用物质证明宣告书 T-SP-042-E》归档于 QS，保存年限为三年。

---